

大塚電子Webセミナー

光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、
先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。

Seminar

15:00~16:10

2025
12/23
Tuesday

ウェーハとスラリーとの静電相互作用の 評価法と半導体プロセス技術の紹介

半導体の CMP(研磨) プロセスにおける静電相互作用は、研磨レートやウェーハ表面の欠陥やパーティクルの発生に影響を与えます。そこでスラリーの分散性やウェーハ表面のゼータ電位を測定することで、その吸着性や洗浄性などの静電相互作用の評価法について解説します。また、半導体プロセスにおけるウェーハの品質評価技術として、当社が提供する膜厚や表面構造の評価例をご紹介します。

* 本セミナーは2024年12月に放映したものを配信いたします。

関連機器



ゼータ電位・粒子径・
分子量測定システム
ELSZneo



顕微分光膜厚計
OPTM series



光波動場三次元顕微鏡
MINUK

お申込み方法

本セミナーは無料で参加できます。
下記のHPより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

<https://www.otsukael.jp/event/detail/eventid/526>



ご視聴方法：本セミナーは、Microsoft Teams を使用します。

大塚電子株式会社

お問い合わせ

担当：岡本・真木

■本社・営業部 TEL. (072) 855-8550
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3 丁目 26-3

■東京支店 TEL. (042) 644-4951
〒192-0082 東京都八王子市東町 1-6 橋完 LK ビル 2F

□ E-Mail OELJP-webseminar@otsuka.jp